

锦州神工半导体股份有限公司

2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：万元 币别：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	14,450.47	53,923.65	-73.20
营业利润	-8,722.48	17,757.13	-149.12
利润总额	-8,720.46	17,783.69	-149.04
归属于母公司所有者的净利润	-6,327.12	15,814.16	-140.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-6,666.80	15,473.66	-143.08
基本每股收益（元）	-0.39	0.99	-139.39
加权平均净资产收益率	-4.13%	10.84%	减少 14.97 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	195,559.06	175,965.86	11.13
归属于母公司的所有者权益	176,763.32	157,326.64	12.35

股本（万股）	17,030.57	16,000.00	6.44
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.38	9.83	5.60

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年度报告为准。数据若有尾数差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023 年公司实现营业总收入 14,450.47 万元，同比下降 73.20%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,327.12 万元，同比下降 140.01%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,666.80 万元，同比下降 143.08%。

报告期末，公司总资产 195,559.06 万元，同比增长 11.13%；归属于母公司的所有者权益 176,763.32 万元，同比增长 12.35%；归属于母公司所有者的每股净资产 10.38 元，同比增长 5.60%。

报告期内，受行业周期及全球经济环境影响，公司大直径硅材料业务收入较上年大幅下降，产能利用率下滑，导致公司整体净利润较上年大幅下滑。同时，本报告期内计提了存货跌价准备，也导致了公司净利润的下降。

目前公司硅零部件和硅片业务正处在市场开拓期，公司将克服行业波动等因素带来的不利影响，积极把握机遇、持续优化产品结构、稳步扩大生产规模、通过完善众多关键技术指标实现全球领先的竞争优势，满足客户对品质的严苛要求。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）	变动原因
营业总收入	14,450.47	53,923.65	-73.20	报告期内，受行业周期及全球经济环境影响，公司大直径硅材料业务收入
营业利润	-8,722.48	17,757.13	-149.12	
利润总额	-8,720.46	17,783.69	-149.04	
归属于母公司所有者的	-6,327.12	15,814.16	-140.01	

净利润				较上年大幅下降，产能利用率下滑，导致公司整体净利润较上年大幅下滑。同时，本报告期内计提了存货跌价准备，也导致了公司净利润的下降。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-6,666.80	15,473.66	-143.08	
基本每股收益（元）	-0.39	0.99	-139.39	
加权平均净资产收益率	-4.13%	10.84%	减少 14.97 个百分点	

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度的定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024年2月23日